

全層IVHプリント配線板技術「F-ALCS」

基板の常識を覆す待望のテクノロジー「F-ALCS (F-All Layer Z-Connection Structure)」

配線収容能力を極限まで高められる自由度の高い革新的な基板技術「F-ALCS」 (エフアルシス)

- ◆ 必要な部分にのみIVH (Interstitial Via Hole) が配置できるため配線有効エリアが拡大
- ◆ 同じ層数の貫通基板と比較して2倍以上の配線収納が可能

■ 設計の自由度が向上

- 全てのビアをIVH化可能で、配線有効エリアが拡大
- 全てのビアをレーザー加工で形成可能で、パッドも小径化
- 不要なビアの削除で部品実装エリアも拡大

■ オープンスタブレス構造

- 全層IVH構造により、ビア部分に高速信号伝送の阻害要因となるスタブを排除可能でリターンロスを低減

■ 製造期間を短縮

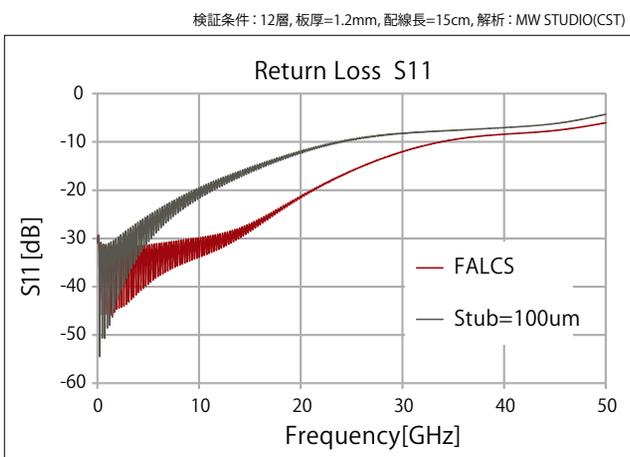
- 「一括積層工法」「メッキレス」で、製造工程を従来比較で50%削減

■ 環境に配慮

- ウェット処理の製造工程削減によるエネルギー低減で環境に優しい製品の実現化に貢献

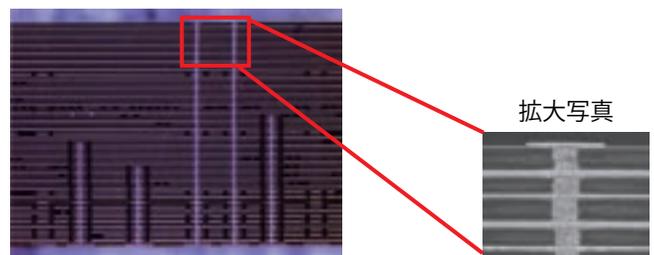
● 効果検証：電気特性

スタブレスで、リターンロスを低減

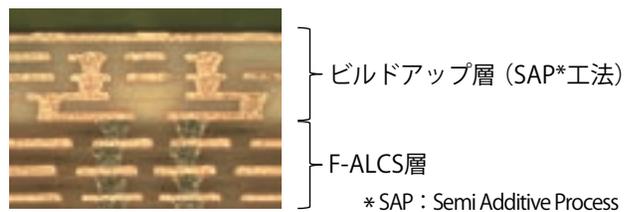


● 対応製品：基板層構成

全層F-ALCSタイプ



F-ALCSコア+ビルドアップ (SAP*工法)



● 効果検証：プロセスステップ

メッキレス、一括積層工法でプロセスを半減

